

电子工艺及电子工程设计



[电子工艺及电子工程设计 下载链接1](#)

著者:汤元信 元学广 刘元法

出版者:北京航空航天大学出版社

出版时间:1999-7

装帧:

isbn:9787810128735

该书是在多年教学实践的基础上，为解决电气类、电子工程类等专业的《电子工艺实习》和《生产实习》之用而编写。全书包括常用电子材料、安全用电、接地与屏蔽、电子元器件、焊接技术、印制电路板的设计与制作、工业设计与安装技术、产品开发与文件共八章。该书涉及面广、实用性强、重点突出。对代表着电子技术发展方向的表面安装技术（SMT）和在线可编程逻辑器件（ISPLD）以及当前国内外积极推行的产品“质量

作者介绍:

目录: 第一章 常用电工材料
第二章 安全用电
第三章 电子线路中的接地与屏蔽
第四章 电子元器件
第五章 焊接技术
第六章 印刷电路板设计与制作工艺
第七章 工业设计与安装技术
第八章 产品开发和技術文件
主要参考文献
· · · · · (收起)

[电子工艺及电子工程设计_下载链接1](#)

标签

评论

[电子工艺及电子工程设计_下载链接1](#)

书评

[电子工艺及电子工程设计_下载链接1](#)